

二ヘッドインダクター レーザー剥離装置

パーツフィーダーを使用してワークを直接載具に供給し、CCDによる高精度な位置決めを行った後、2台のレーザーを同時に使用して加工することで、インダクター表面を微細加工し、顧客の加工要求を満たす効果を実現します。



製品特徴 PRODUCT HIGHLIGHTS

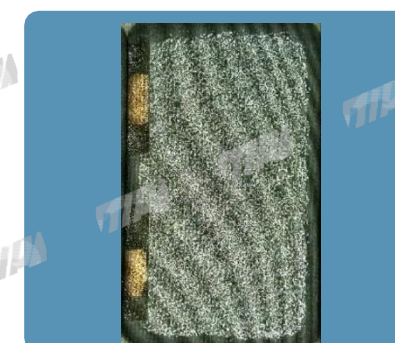
HiPAが自社開発したレーザー発振器を搭載したインダクター剥離装置は、高い安定性を誇り、迅速なアフターサービス対応を実現します。

- ◆ **高速ワークアップロード:** ワークのアップロード速度は18,000PCS/Hを超えます。
- ◆ **高精度:** インダクターのレーザー剥離精度は $\pm 0.05\text{mm}$ 以内を実現。
- ◆ **高効率:** ダブルレーザーを同時に使用し、最大21,000PCS/H以上の処理が可能。
- ◆ **独自開発レーザー光源:** カスタマイズ可能なファイバーレーザーを採用し、最適なコストパフォーマンスを提供。さらに、迅速かつ便利なアフターサービスを実現。
- ◆ **自社開発マーキングボード:** 顧客のカスタマイズニーズに対応した専用マーキングボードを開発・提供。

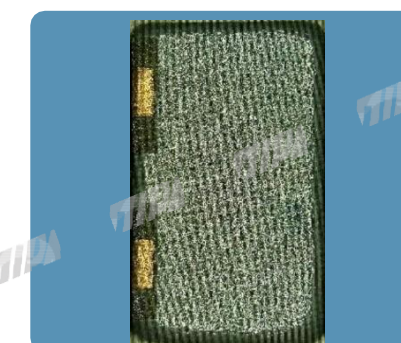
アプリケーション効果 APPLICATION EFFECTS



正面



右側面



左側面

機械

MECHANICAL

項目	規格	オプション
設備型番	HiPA-LP-UV15-II	/
設備サイズ	1300mm × 1200mm × 1800mm	/
重量	1000kg	/
ワーク供給方式	パーツフィーダーで直線ワークアップロード	/
ワークサイズ	2520/2016/2012	/
除塵構造	アヒル口式除塵構造	/
治具	軟磁性板+セラミック	/
ノイズ	≤75db	/

電気

ELECTRICAL

項目	規格	オプション
定格電圧	単相 AC 220V 50/60HZ	/
定格電流	13.6A	/
定格パワー	3kW	/
気圧	0.4~0.6Mpa	/

レーザー

LASER&PROCESS

項目	規格	オプション
製品仕様	2520/2016/2012	/
剥離要求	片面インダクターレーザー剥離	/
剥離精度	≤±0.05mm	/
レーザーパラメーター	UV 15W	IR 30W
ガルバノスキャン範囲	F254 (カメラレンズ視野 75 × 75)	/
ガルバノスキャン速度	1mm/s ~7000mm/s	/
ガルバノ重複位置決め精度	0.01mm	/
マーキングボード	JPT 自作	/

視覚

VISION

項目	規格	オプション
カメラ	HiPA-CH5120-5GM	/
レンズ	DTCM111-110-AL 視野 75mm × 75mm	/
単ピクセル精度	15μm	/
位置決め精度	45μm	/
光源	白色 リングライト	/